

2012年8月31日

お客様各位

富士通セミコンダクター株式会社

LSI 後工程製造拠点の譲渡に関する基本契約の締結について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度、株式会社ジェイデバイスと弊社は弊社の100%子会社である富士通インテグレートッドマイクロテクノロジー株式会社のLSI 後工程製造拠点のジェイデバイス社への譲渡に関する基本契約を締結致しました。本契約は、両社が半導体製造事業における戦略的パートナーとして長期的な互惠関係を構築することを目的としており、年内の最終契約締結・本件取引完了を目指しております。本契約により、富士通インテグレートッドマイクロテクノロジー株式会社の宮城工場と会津工場は、本年内にジェイデバイス社に譲渡し、同社の製造拠点となる予定です。両工場の従業員は、全員ジェイデバイス社に転籍する予定です。また、富士通インテグレートッドマイクロテクノロジー株式会社の九州工場は順次ジェイデバイス社の九州地区工場に設備を移設し、最終的には全ての製造を移管する予定です。その際、既存商品は移設先の工場で従来と同じ品質での製造を継続致します。同工場の従業員については、ジェイデバイス社への転籍、あるいは富士通グループ内における再配置等を進めていくことを予定しております。

譲渡予定の後工程で製造される商品は譲渡後も、弊社から従来と同等の品質・納期とサービスにて、お客様に提供させていただきます。

弊社は今後とも商品開発とサービスの一層の充実を図り、引き続き商品の安定供給に努めていく所存でございますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

【添付】 プレスリリース文 1枚

以 上